

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2026-001

## 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于联合投资人共同对外投资暨收购 逐点半导体交割完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿科技（上海）有限公司（以下简称“天遂芯愿”）进行投资（以下简称“本次投资”），并以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体（上海）股份有限公司（以下简称“逐点半导体”）的控制权（与本次投资合称“本次交易”）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于联合投资人共同对外投资暨收购逐点半导体（上海）股份有限公司控制权的公告》（公告编号：2025-062）。

2025年12月12日，公司与天遂芯愿、华芯鼎新（北京）股权投资基金（有限合伙）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）、北京屹唐元创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）和上海涵泽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“共同投资方”）签署《增资协议》和《股东协议》等交易文件，天遂芯愿拟新增注册资本94,000万元。本次投资完成后，天遂芯愿的注册资本将变更为95,000万元，公司将持有天遂芯愿40%股权、成为天遂芯愿单一第一大股东，并将根据相关交易协议控制天遂芯愿的多数董事席位并享有对天遂芯愿的控制权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于联合投资人共同对外投资暨收购逐点半导体的进展公告》（公告编号：2025-080）。

截至本公告披露日，根据本次交易项下协议的履行情况，各方均同意本次交易已达可交割状态，公司与共同投资方已根据《增资协议》约定向天遂芯愿完成

出资和增资，天遂芯愿已根据《股份购买协议》约定向逐点半导体相关原股东支付收购价款，各方已根据交易协议约定完成交割。交割完成后，公司享有天遂芯愿的控制权，天遂芯愿持有逐点半导体 100%股份，逐点半导体纳入公司合并报表范围。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日